# Filtro paso bajo de montaje superficial · DC–400 MHz

Antes de diseñar la placa, compruebe el patrón de montaje superficial para 50 Ω y el encapsulado de 18.8 × 11.18 × 6.86 mm.

## Prestaciones de RF

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Banda de paso | DC–400 MHz |
| Pérdida de inserción en la banda de paso [1] | 0.7 dB (Típico) |
| Rechazo fuera de banda [2] | ≥20 dB |
| ROE [1] | 1.36:1 (Típico) |
| Frecuencia a −3 dB | 435 MHz |

[1] DC–400 MHz

[2] 500–2400 MHz

## Valores de diseño

Garantizado por diseño

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia admisible | 1 W |
| Temperatura de funcionamiento | −40...+85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −55...+100 °C |

## Respuesta típica medida

| Frecuencia (MHz) | S11 ROE | S22 ROE | Pérdida S12 (dB) | Retardo S12 (ns) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.02 | 1.02 | -0.04 | 0.97 |
| 43 | 1.02 | 1.02 | -0.04 | 0.97 |
| 86 | 1.13 | 1.12 | -0.07 | 1.1 |
| 129 | 1.22 | 1.21 | -0.13 | 1.2 |
| 171 | 1.26 | 1.25 | -0.17 | 1.32 |
| 214 | 1.23 | 1.22 | -0.17 | 1.56 |
| 257 | 1.23 | 1.22 | -0.17 | 1.56 |
| 300 | 1.13 | 1.11 | -0.19 | 1.94 |
| 343 | 1.1 | 1.1 | -0.25 | 2.96 |
| 386 | 1.24 | 1.25 | -0.35 | 6.26 |
| 429 | 1.06 | 1.04 | -0.65 | -1.6 |
| 471 | 6.65 | 10.74 | -5 | -5.67 |

## Respuesta típica medida

| Frecuencia (MHz) | S11 ROE | S22 ROE | Pérdida S12 (dB) | Retardo S12 (ns) |
|---|---|---|---|---|
| 514 | 34.81 | 46.79 | -36.01 | 0.89 |
| 557 | 34.81 | 46.79 | -36.01 | 0.89 |
| 600 | 41.34 | 49.85 | -26.5 | 1.01 |

## Especificaciones mecánicas

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones del encapsulado | 18.8 ±0.2 × 11.18 ±0.2 × 6.86 ±0.2 mm |
| Impedancia de RF | 50 Ω |
| Montaje | Montaje superficial |
| Terminales de RF | 1, 8 |
| Terminales de masa | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Grado de calidad | Industrial |
| Dimensiones de una isla de soldadura | 1.52 × 1.4 mm |
| Distancia entre centros de islas adyacentes de una fila | 5.08 mm |
| Dimensiones exteriores de la matriz de islas | 16.76 × 11.94 mm |

## Montaje en PCB

Limpie la superficie del producto sin sumergir el filtro en líquido de limpieza. Admite soldadura por refusión a 190 °C. La huella de la placa de circuito impreso tiene dos filas de cuatro islas. En la vista inferior, con el terminal 1 arriba a la izquierda, la fila superior contiene los terminales 1, 3, 5 y 7, y la inferior los terminales 2, 4, 6 y 8. Los terminales 1 y 8 son las conexiones de entrada/salida de RF. Los terminales 2 a 7 se conectan a masa. En la vista inferior, el rebaje del terminal 1 tiene 1.52 mm de ancho y se prolonga 1.02 mm hacia el interior desde el borde superior. Los centros de los terminales 2 y 4 están a 5.08 mm. El centro del terminal 2 está a 1.78 mm del borde izquierdo. La metalización del terminal 8 se extiende 3.54 mm desde el borde derecho y 2.22 mm desde el borde inferior.

**Aviso del documento**

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.